

LEAD FREE SOLDER PASTE

LH ハロゲンフリータイプ

ハロゲンフリー規格を満たしており
なおかつ従来品と同等の
濡れ上がり性を実現しました。

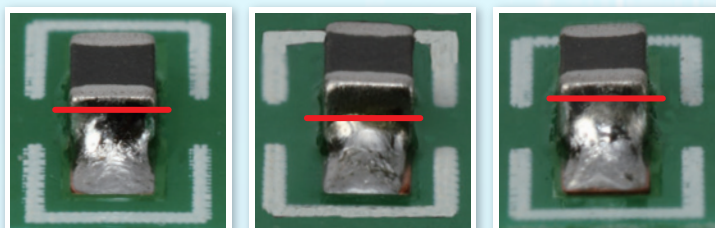
Fine Solder



Product Features 製品特性

■ ハロゲンフリーでありながら良好な濡れ上がり性

ハロゲンフリー規格(塩素(Cl):900ppm以下、臭素(Br):900ppm以下、塩素(Cl)及び臭素(Br):1500ppm以下)を満足する高い信頼性を有しながら、ハロゲンフリーではない通常品と同等の良好な濡れ上がり性を実現しました。



FLF01-LH

他社相当品

通常品

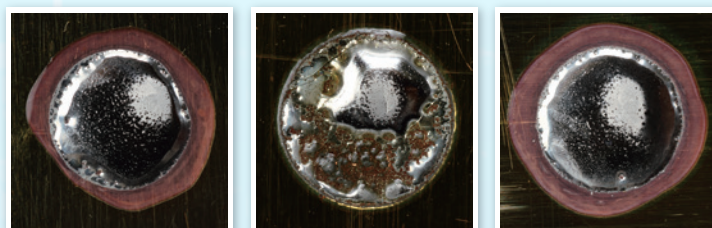
ソルダペーストを基板上に厚さ120 μ mで印刷後、
2010chip部品をマウント

160~190 $^{\circ}$ C プリヒート90sec 240 $^{\circ}$ Cでリフロー加熱

濡れ上がり状態を観察

■ 優れた耐熱性

独自の活性剤技術によって幅広い活性温度域を確保し、耐熱性の向上を図りました。



FLF01-LH

他社相当品

通常品

ソルダペーストを黄銅板上に ϕ 6.5mm、厚さ200 μ mで印刷

200 $^{\circ}$ Cプリヒート3min

240 $^{\circ}$ Cでリフロー加熱

溶融状態を観察

項目	FLF01-LH	試験規格
合金組成	Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%	JIS Z3282
固相線温度	約217 $^{\circ}$ C	JIS Z3282
液相線温度	約219 $^{\circ}$ C	JIS Z3282
はんだ粉末サイズ	20~38 μ m(Type4)	JIS Z3284(J-STD-005)
フラックス含有量	11.50%	JIS Z3197
ハライド含有量	0.03%	JIS Z3197
粘度特性	190Pa·s	JIS Z3284
チクソトロピー指数	0.54	JIS Z3284
銅板腐食試験	合格	JIS Z3197
絶縁抵抗試験(85 $^{\circ}$ C 85%RH 168hr)	1.0 \times 10 $^{\Omega}$ 以上	JIS Z3197
マイグレーション試験(85 $^{\circ}$ C 85%RH 1,000hr)	異常なし	JIS Z3197
広がり率	87%	JIS Z3197

